

NOTICE OF GROUNDS FOR REJECTION

Patent Application Serial No. 2001-220496

Examiner: Keiji SHINKAWA

Drafted Date: March 24, 2004

Mailed Date: March 30, 2004

Patent Agent for the Applicant: Kenji YOSHIDA and two
others

Applied Provision: Patent Law section 29(2)

This patent application should be rejected on the following grounds. The applicant may submit a statement of his/her argument within sixty (60) days from the mailing date of this notice.

GROUND S

1. Claims 1 to 18 of the present application are rejected under the Patent Law section 29(2), because the inventions defined therein could have easily been made by a person having ordinary skill in the art prior to the filing date of this application based on the inventions shown in the following cited references published in Japan or elsewhere.

References Cited:

1. Japanese Patent Laid-Open Publication NO. Hei 11-340701
2. Japanese Patent Laid-Open Publication NO. Sho 60-62702
3. Japanese Patent Laid-Open Publication NO. Hei 11-136009

NOTE

With regard to claims 1 to 18
References 1 to 3

Remarks:

Reference 1 describes a waveguide connection portion formed by two substrates disposed facing each other, in which on contact regions facing each other, conductive adhesives are provided with a gap of $\lambda/4$ or less therebetween. Reference 1 further describes that a cross section of the waveguide connection portion is a rectangular shape, and that a substrate is a multi-layered substrate.

It is believed that the size of the contact region, the position where the conductive adhesive is provided, or the like can be appropriately selected experimentally as necessary by a person with ordinary skill in the art.

Reference 2 describes that a solder resist is applied on the solder connection portion.

Reference 3 describes that the boundary surface between two waveguide lines is formed by one line of through holes.

Further grounds for rejection will be notified if and when they are found.

SEARCH REPORT OF PRIOR ART DOCUMENTS

Technical field searched: IPC Ver. 7 H01P 1/04
H01P 3/12
H01L 23/12
H05K 1/14

DB Name

Prior art documents:

Japanese Patent Laid-Open Publication No. Hei 6-303001
Japanese Patent Laid-Open Publication No. 2000-196301

This Search Report of Prior Art Documents does not

constitute grounds for rejection.

拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願2001-220496
起案日	平成16年 3月24日
特許庁審査官	新川 圭二 8623 5T00
特許出願人代理人	吉田 研二(外 2名) 様
適用条文	第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記 of 刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記

1. 特開平11-340701号公報
2. 特開昭60-62702号公報
3. 特開平11-136009号公報

請求項1～18に係る発明に対して

上記引用例1～3

上記引用例1には、2つの基板を対向配置して構成した導波管接続部であって、互いに対向するコンタクト領域に $\lambda/4$ 以下の間隔で導電性接着剤を設けたものが記載されている。さらに、導波管接続部断面を矩形とすること、基板を積層基板とすることも記載されている。

コンタクト領域の大きさや導電接着剤を設ける位置等は当業者が必要に応じて実験的に適宜選択し得るものと認められる。

上記引用例2には、半田接続部にソルダレジストを塗布することが記載されている。

上記引用例3には、2つの導波管列の境界面を1列のスルーホール列で形成することが記載されている。

拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野

IPC第7版	H01P	1/04
	H01P	3/12
	H01L	23/12
	H05K	1/14

DB名

・先行技術文献 特開平6-303001号公報
特開2000-196301号公報

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。